

# 第四届高端制造电子电镀论坛（FEPAM-2025）会议通知

## Announcement of the 4th China Forum of Electronic Plating for Advanced Manufacturing (FEPAM-2025)

在当前全球产业链重构、科技竞争加剧的背景下，高端制造产业作为半导体、新能源等战略领域的核心支撑技术，正面临前所未有的机遇与挑战。高端制造电子电镀论坛（FEPAM）是国内首个电子电镀领域贯通基础研究和应用终端的全国性年度行业论坛，已成功举办三届，共吸引来自全国40余所高校和科研院所及百余家企事业单位总计近千人次参会。

第四届高端制造电子电镀论坛（FEPAM-2025）定于2025年6月27-29日在福建省厦门市举行，论坛由厦门大学孙世刚院士倡议召开，高端电子化学品国家工程研究中心（重组）主办，厦门大学化学化工学院、表界面化学全国重点实验室、衢州高端电子化学品创新研究院、上海市集成电路关键工艺材料重点实验室、厦门大学国家集成电路产教融合创新平台、嘉庚创新实验室协办。

本届论坛以深化科研自主创新、加速国产替代进程、构建安全韧性供应链为目标，邀请知名专家学者、行业企业代表及学生代表围绕芯片制造和封装集成电子电镀，高端制造电子电镀基础、工艺技术与设备，高端电子化学品，下一代半导体（电子）材料等相关领域的前沿动态、技术瓶颈与关键科学问题展开深入研讨及交流。大会组委会热忱欢迎各高等院校、科研院所及企事业单位的同仁与研究生踊跃参加，共同探讨新形势下高端制造电子电镀技术的发展路径。

### 一、论坛学术委员会

主任：张锁江院士

委员：陈军院士、黄如院士、李玉良院士、刘明院士、彭练矛院士、任其龙院士、张荣院士、安茂忠、成旦红、何为、李明、刘仁志、欧忠文、史训清、孙蓉、邢巍、杨防祖、于大全、郁祖湛（按姓名拼音顺序排序）

### 二、论坛组织委员会

主席：孙世刚院士

委员：陈忠、陈智栋、程俊、丁桂甫、方宁、洪文晶、黄凯、马盛林、宋毅、孙建军、王增林、卫国英、徐群杰、叶金堆、詹东平、周保学（按姓名拼音顺序排序）

### 三、论坛日程

地点：厦门航空费尔蒙酒店

日期	时间	内容
6月27日（周五）	14:00-21:00	报到注册
6月28日（周六）	08:30-09:00	开幕式、大会报告、行业对话
	09:00-09:50	大会报告（一）
	09:50-10:20	茶歇、自由交流
	10:20-11:10	大会报告（二）
	11:10-12:10	行业对话/高峰座谈
	12:10-14:00	大会餐叙
	14:00-15:30	分会报告（邀请报告、口头报告）
	15:30-16:00	茶歇、自由交流
	16:00-17:20	分会报告（邀请报告、口头报告）
	17:20-18:30	墙报展示及快闪报告

续表

日期	时间	内容
6月29日（周日）	08:30-09:50	分会报告（邀请报告、口头报告）
	09:50-10:20	茶歇、自由交流
	10:20-12:00	大会报告（三）（四）
	12:00-12:20	闭幕式
	12:20-14:00	大会餐叙

\*详细议程安排以会务组当日发放的论坛手册为准

## 四、论坛对象

高端制造电子电镀、高端电子化学品及下一代半导体（电子）材料等相关领域专家学者、企业代表、学生代表。

## 五、参会费用

非学生参会代表会务费 2000 元 / 位；  
参会学生会务费 1200 元 / 位（注册报到时需凭有效学生证）；  
论坛食宿和交通费用自理。

## 六、报名方式

本届论坛报名方式为在线报名，线上报名截止时间为 2025 年 6 月 26 日 24 时；会务组收到报名信息后进入审核阶段，报名通过后将以邮件形式向确认参会代表发送 FEPAM-2025 后续论坛具体安排事项，请参会代表注意查收相关邮件。

线上报名截止后可直接到会议现场报名



（长按识别或扫一扫二维码进入线上报名）

## 七、口头报告

本届论坛诚邀领域专家学者、行业企业代表及学生代表围绕芯片制造和封装集成电子电镀，高端制造电子电镀基础、工艺技术与设备，高端电子化学品，下一代半导体（电子）材料等相关领域的前沿动态、技术瓶颈与关键科学问题各抒己见，若您于线上报名时选择【申请做口头报告】，请于 2025 年 5 月 30 日前将报告摘要发送至邮箱 [nerccem@xmu.edu.cn](mailto:nerccem@xmu.edu.cn)。



(长按识别或扫一扫二维码下载报告摘要模板)

## 八、墙报展示及快闪报告

为提高论坛水平，活跃学术气氛，促进青年人才培养及加强科学思想交流，本届论坛鼓励广大参会代表特别是学生投稿参加墙报展示及快闪报告，活动说明如下：

活动流程				
1	<p>通过下方二维码报名并选择【申请墙报展示及快闪报告】。</p>  <p>(长按识别或扫一扫二维码进入线上报名)</p>			
2	<p>通过下方二维码下载报告摘要模板，填写摘要并于2025年6月6日前发送至会务组邮箱nerccem@xmu.edu.cn。</p>  <p>(长按识别或扫一扫二维码下载报告摘要模板)</p> <p>墙报内容要求： 符合论坛主题，围绕芯片制造和封装集成电子电镀，高端制造电子电镀基础、工艺技术与设备，高端电子化学品，下一代半导体(电子)材料等相关领域展开。</p>			
3	墙报报告摘要经组委会审核通过后，由会务组于2025年6月20日前通过邮件通知墙报展出现场安排。			
4	墙报入选人员请按90cm(宽)×120cm(高)的尺寸要求自行设计并彩色竖版打印墙报，于2025年6月27日14:00-21:00带至会议现场并根据会务组要求自行张贴。			
5	墙报快闪报告时间为2025年6月28日17:20-18:30，届时，请参展人于各自墙报前进行快闪报告及交流。			
6	本论坛为参展学生设置“优秀墙报奖”			
	<table border="1"> <tr> <td>评选标准</td> <td>A.学术价值(40%)：研究创新性、科学性； B.展示效果(30%)：设计美观、图文清晰； C.报告表现(30%)：参展人现场快闪报告表现及答疑能力。</td> </tr> <tr> <td>评选流程</td> <td>A.初选：由论坛组织委员会筛选符合要求的墙报； B.终选：专家评审团现场打分； C.颁奖：闭幕式颁发“优秀墙报奖”。</td> </tr> </table>	评选标准	A.学术价值(40%)：研究创新性、科学性； B.展示效果(30%)：设计美观、图文清晰； C.报告表现(30%)：参展人现场快闪报告表现及答疑能力。	评选流程
评选标准	A.学术价值(40%)：研究创新性、科学性； B.展示效果(30%)：设计美观、图文清晰； C.报告表现(30%)：参展人现场快闪报告表现及答疑能力。			
评选流程	A.初选：由论坛组织委员会筛选符合要求的墙报； B.终选：专家评审团现场打分； C.颁奖：闭幕式颁发“优秀墙报奖”。			

## 九、赞助合作

本届论坛开放少量企业赞助及合作席位，并为赞助单位提供丰富回馈，欢迎洽谈。



(长按识别或扫一扫二维码下载文档了解赞助方案)

联系人：黄老师

huangbz@xmu.edu.cn 15260225305

**参展单位注意事项：**展出地点为厦门航空费尔蒙酒店三楼天鸿宴会厅序厅；布展安排暂定为 2025 年 6 月 27 日布展、2025 年 6 月 29 日下午撤展。

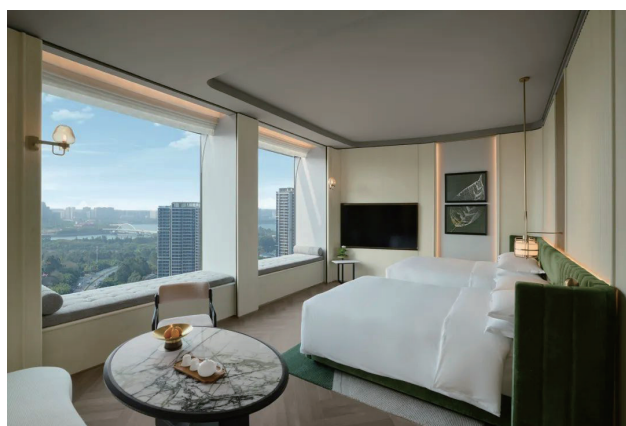
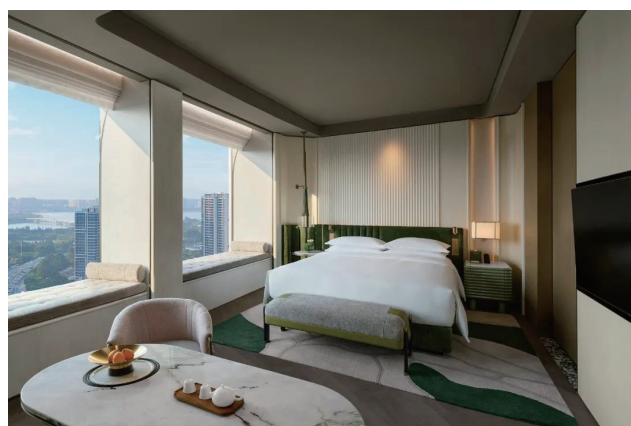
## 十、注册报到

**报到地点：**厦门航空费尔蒙酒店（1 楼）；

**报到时间：**2025 年 6 月 27 日 14:00—21:00（27 日当天未能报到的，请于 28 日上午论坛开始前至酒店 3 楼天鸿厅报到）。

## 十一、会议住宿及周边

本届论坛会务组为您提供代订论坛期间厦门航空费尔蒙酒店住宿，请您于在线报名中提交订房需求。



**会务房型：**费尔蒙经典大床房 / 双床房

**会议补贴价：**600 元 / 间夜（含单早）；700 元 / 间夜（含双早）

**会务餐饮：**参会代表凭会务组制发的餐券用餐

**温馨提示：**

餐会代表住宿费用自理；

会务组不提供协调拼房服务；

如需入住厦门航空费尔蒙酒店，请务必提前通过会务组预订方可享受会议补贴价，房间数量有限，先订先得；

参会代表亦可自订论坛周边酒店。

#### 论坛周边：

A. 酒店地址：福建省厦门市湖里区金山街道东黄路 325 号；

B. 酒店电话：0592-3016666；

C. 交通信息：

\* 距厦门高崎国际机场 8.8 公里，约 15 分钟车程；

\* 距厦门站 16 公里，约 27 分钟车程；

\* 距鼓浪屿 19 公里，约 23 分钟车程；

\* 距南普陀寺 / 厦门大学 / 白城沙滩 16 公里，约 21 分钟车程；

\* 距中山路 / 八市 19 公里，约 22 分钟车程；

\* 距银泰百货 0.5 公里，约 8 分钟步行；

\* 距万达广场 1.3 公里，约 5 分钟车程；

\* 距观音山商务区 4.7 公里，约 12 分钟车程。

## 十二、会务组联系方式

参会报名：银老师 yinpu@xmu.edu.cn 18695625403

住宿餐饮：任老师 rendd@xmu.edu.cn 13616060510

注册报到：李老师 zhenli@xmu.edu.cn 15810950358

注册缴费：戴老师 daish@xmu.edu.cn 18059257592

论坛资料 & 赞助合作：黄老师 huangbz@xmu.edu.cn 15260225305

论坛会场：许老师 xusuxia0429@xmu.edu.cn 15959209221

墙报快闪：梁老师 xlliang@xmu.edu.cn 15711570810